

AIM 为 SMT、波峰焊、手工焊接及其它应用提供各种合金配方。以下列表为电子行业常用的合金。若有需求也可以提供其他类型的合金。

				焊料产品表格*			
合金	熔点 °C	特点		焊膏	焊条	带芯焊线	实芯焊线
低温							
Sn42/Bi58	138	适用于低温焊接应用。合金含铋量高，可能要特别注意其特殊性能。		●	●		●
Sn42/Bi57/Ag1							
Sn62/Pb36/Ag2	179	不符合 RoHS 和 REACH 标准。		●	●	●	●
Sn63/Pb37	183						
高可靠性							
REL22™ Sn/Ag/Cu/Bi/Sb/X	210-212	高可靠性，高强度无铅合金。在极端的服务环境下特别耐用。		●	●	●	●
CASTIN® Sn/Ag2.5/Cu0.8/Sb0.5	217-219	跌落测试性能优于 SAC305。		●	●	●	●
锡银/锡银铜 (SAC)							
SAC305 Sn/Ag3/Cu0.5	217-220	用于 SMT 和通孔焊接的工业标准产品。合金纯度高，性能良好。					
SAC387 Sn/Ag3.8/Cu0.7				●	●	●	●
SAC405 Sn/Ag4/Cu0.5							
Sn96.5/Ag3.5	221	共晶锡银合金。用于高温和高可靠性互连应用。		●	●	●	●
低银/无银无铅							
REL61™ Sn/Ag/Cu/Bi	208-215	高可靠性，高强度/低银无铅合金。润湿性好。减少锡须的形成。		●	●	●	●
REL99 Sn/Cu/Ni/Ge	227	无银合金，用于波峰焊和手工焊的高性价比产品。		●	●	●	●
SAC-B 0307 Sn/Ag0.3/Cu0.7	217-227	SAC 合金的低成本替代品。由于熔点较高，主要用于波峰焊接，选择焊接和手工焊接。		●	●	●	●
SAC-B 0107 Sn/Ag0.1/Cu0.7							
SN100C® Sn/Cu0.7/Ni0.05+Ge	227	接近共晶，低银/无银合金，适用于波峰焊接和手工焊接的高性价比产品。		●	●	●	●
Sn99.3/Cu0.7							
Sn97/Cu3	227-300	无铅合金适用于高温焊接应用。		●	●	●	●

*可供应的焊料产品类型可能会有变化

不应将熔点作为热保护元件的设计标准